

CSPACK をご使用前に

1. 本製品は、システムでの開発、評価での使用を想定したものです。また国内の使用に際し、電気用品安全法および電磁波障害対策の適用を受けておりません。開発および評価用のソケットとしてご使用下さい。
2. CSPACK は、振動及び衝撃環境にはご使用になれません。
3. CSPACK は、ハンダボールの表面の酸化を防ぐ為、真空パックされています。パック開封後は、なるべくその日のうちにハンダ付けすることをお奨めします。
(次の日になる場合は、デシケーター内で保管して下さい。)
4. CSPACK はピン曲がりを防ぐ為、薄緑色の保護カバーと一緒にネジ止めされ真空パックされています。飛散フラックスの付着防止の為、ハンダリフロ終了までは保護カバーを付けておいて下さい。
5. 推奨リフロ条件：CSPACK コネクタの表面温度（共晶ハンダの場合）
プリヒート部：150～180、180秒程度
本加熱：210以上、30～60秒程度（共晶ハンダの場合）
260、10秒以内（鉛フリーハンダの場合）
6. CSPACK は、構造上フラックス洗浄液がソケット内に残る為、洗浄は絶対に行わないで下さい。
7. CSPACK をネジ止めする時、添付の精密ドライバー（+）またはトルクドライバーでネジを仮止め後、順次ネジを締めて下さい。1ヶ所のみを強く締めると、接触不良の原因となることがあります。
8. ガイドピン仕様の CSPACK を基板にハンダ付けすると、基板下にガイドピンが約1.4mm（基板厚1.6mm使用時）出ます。この状態で、基板下側よりガイドピンに負荷がかかるとCSPACKのハンダ付け部にストレスがかかり、ソケットの接触不良あるいは、コネクタ破損の原因となりますので、ハンダ付け後は、ガイドピンに負荷のかからないようご注意願います。
9. 製品がケースに梱包されている場合は、ケースを50以上の場所に長時間放置すると変形する場合がありますので、40以下の直射日光の当たらない場所に保管して下さい。